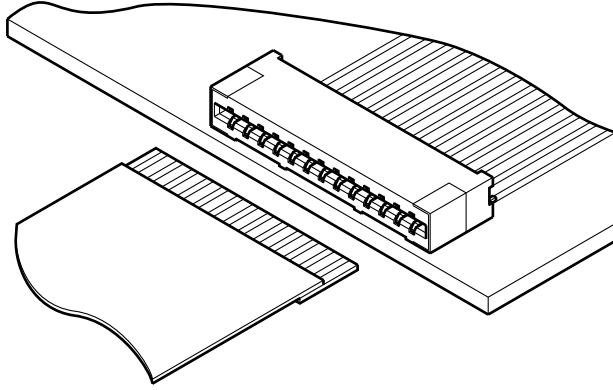


FFS CONNECTOR

1.25mmピッチ / 基板対FFC接続用 / Non-ZIFタイプ



電子機器内部素子のSMT化に対応した1.25mmピッチFFC接続用、表面実装タイプのコネクタです。高接触圧ダブルリーフコンタクト構造による確実な接続、優れた挿入作業性を高さ2.8mmの小型タイプで可能にしました。

■特長

・SMT (表面実装) 対応

基板上実装密度がさらに高まる SMT 化が可能です。

・両面接触による高信頼設計

コンタクトは、ばね性に優れたりん青銅を使用した高接触圧の両面接触構造。さらに接触位置を前後2段階に設定しリード挿入時の嵌合力を分散させることで低挿入力化を実現しました。

・高密度設計

実装高さ 2.8mm の小型高密度設計。

・接続が簡単なスナップイン方式

FFC をコネクタに挿入するだけの簡単な作業でリードを保持するスナップイン方式を採用。

・テーピング供給

耐熱樹脂 (PPS) を使用したエンボステーピング仕様品です。

・嵌合時の浮き上り防止

コネクタの両サイドに補強金具を設け、FFC 接続時のこじり挿抜等によるコネクタの浮き上りを防止しました。

■一般仕様

- ・定格電流：0.5A AC/DC
- ・定格電圧：50V AC/DC
- ・使用温度範囲：-25℃～ +85℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- ・接触抵抗：初期 / 20mΩ 以下
耐熱性試験後 / 30mΩ 以下
- ・絶縁抵抗：800MΩ 以上
- ・耐電圧：AC 500V を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきこと。
- ・適用 FFC：導体ピッチ / 1.25mm
導体幅 / 0.8mm
接触部厚さ / 0.30 ± 0.05mm

※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト (製品情報ページの技術資料末項) に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。

※寸法の単位には mm を採用しています。

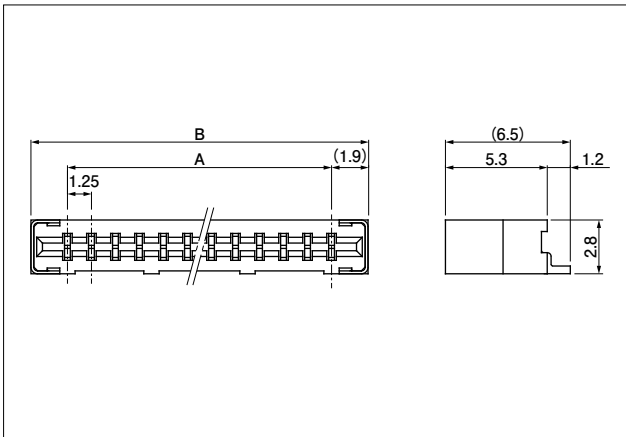
※詳細は弊社までお問い合わせください。

■登録規格

海外規格登録については、弊社ウェブサイト (製品情報ページの技術資料) に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

※海外規格に登録の仕様は、上記の一般仕様と異なる場合があります。

コネクタ



極数	形番	寸法 (mm)		個数／リール
		A	B	
4	04FFS-SP-TF	3.75	7.55	1,000
5	05FFS-SP-TF	5.00	8.80	1,000
6	06FFS-SP-TF	6.25	10.05	1,000
8	08FFS-SP-TF	8.75	12.55	1,000
15	15FFS-SP-TF	17.5	21.3	1,000
21	21FFS-SP-TF	25.0	28.8	1,000
26	26FFS-SP-TF	31.25	35.05	2,000

材 料・表面処理等

コンタクト：銅合金、すずめっき

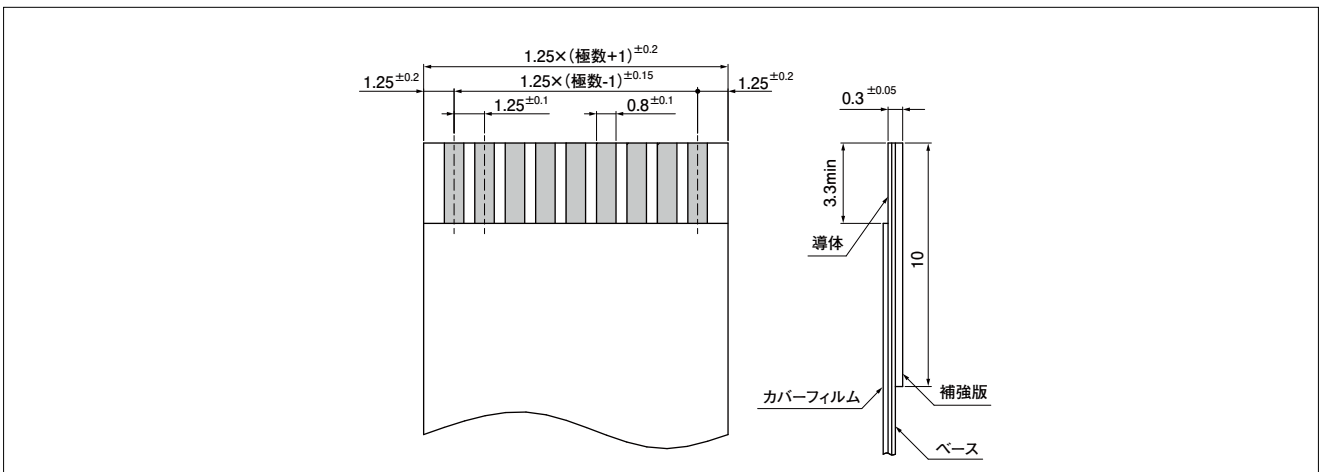
ハウジング：PPS

補強金具：銅合金、すずめっき

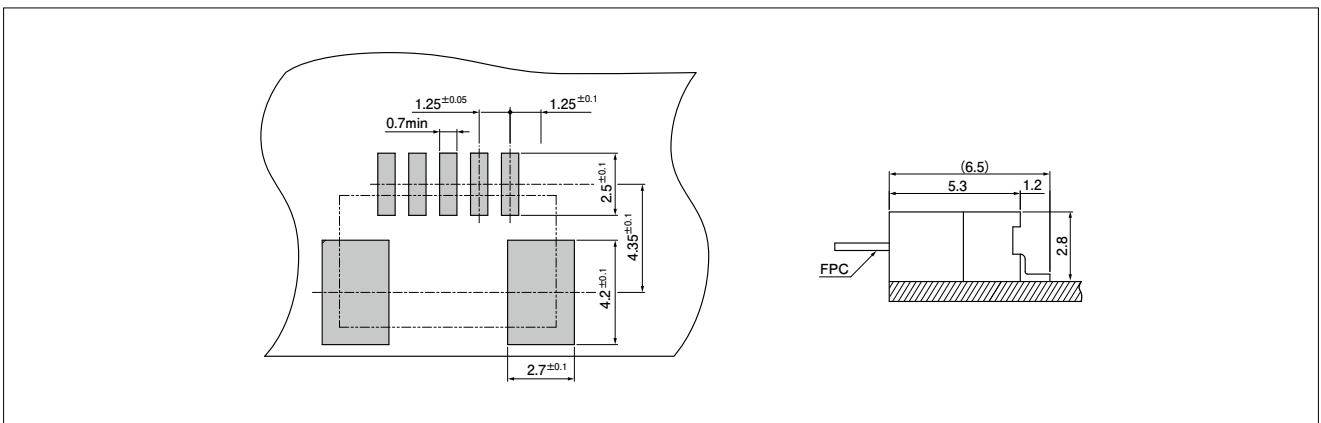
注) 使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト（製品情報ページの技術資料）に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

本製品はエンボステーピング供給品です。詳細は弊社までお問い合わせください。

FFC リード部寸法



基板レイアウト・組立レイアウト



注) 基板のパターンピッチの公差は±0.05で累積しないこと。上図記載の寸法は参考値ですので、詳しくは弊社までお問い合わせください。